

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

◎本研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ieice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 2月7日(木) 10:00~16:55

会場 東京大学本郷キャンパス 42 講義室

議題 配線・実装技術と関連材料技術

1. [招待講演] 高精度デュアルダマシン加工技術

○早川 崇・藤川 誠・野沢秀二・山口達也 (東京エレクトロン)

2. [招待講演] ナノインプリントによるハーフピッチ 14 nm 直接パターンニング 中杉哲郎 (東芝メモリ)

3. [招待講演] 誘導自己組織化による極微細三次元配線形成技術

○福島誉史・マリアッパン ムルゲサン・小柳光正 (東北大)

午後 (13:10~)

4. [招待講演] Stress Investigation of Annular-Trench-Isolated (ATI) Through Silicon Via (TSV)

○Wei Feng・Naoya Watanabe・Haruo Shimamoto・Masahiro Aoyagi・Katsuya Kikuchi (AIST)

5. [招待講演] めっき銅薄膜配線の機械特性と EM 耐性の結晶粒界品質依存性

罗 轶凡・名越優太郎・水野涼太・鈴木 研・○三浦英生 (東北大)

6. [招待講演] p 型 GaN 上に形成した単結晶 Al 配線及びその GaN FET への応用

○原田剛史・宇高孝二・神田裕介・大西克彦・松永啓一・引田正洋・上本康裕 (パナソニック)

7. [招待講演] 微細 CMOS 向け新コンタクト材料: クラスタ気相合成法で形成した Si リッチ W シリサイド膜

○岡田直也・内田紀行・小川真一・金山敏彦 (産総研)

8. [招待講演] 大気中・常温接合可能な基板作成技術

○松前貴司・山本道貴・倉島優一・日暮栄治・高木秀樹 (産総研)

◆応用物理学会共催

【問合先】

諸岡 哲 (東芝メモリ)

TEL [059] 390-7451, FAX [059] 361-2739

E-mail: tetsu.morooka@toshiba.co.jp